Interne TE-Nummer 2288172-6
SFP, SFP+ & zSFP+, Cage Assembly with Integrated Connector,
Data Rate (Max) 32 Gb/s, Internal/External EMI Springs, zSFP+

Thermally Enhanced

Auf TE.com ansehen>

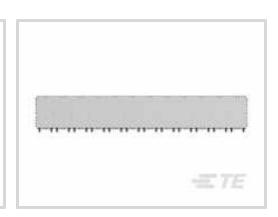


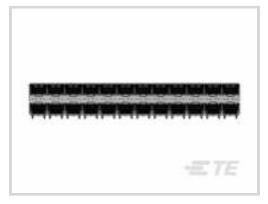
Steckverbinder > Pluggable IO-Steckverbinder und -Cages > SFP, SFP+ und zSFP+ > zSFP+ Zweireihiger Cagesatz: EMI-Feder











Steckbarer I/O – Produkttyp: Cagesatz mit integriertem Steckverbinder

Datenrate (max.): 32 Gb/s

Art der EMV-Eindämmung: Interne/externe EMV-Federn
Steckbare I/O-Anwendungen: zSFP+ Thermally Enhanced

Lichtleiter-Optionen: Mit Lichtleiter

Alle zSFP+ Zweireihiger Cagesatz: EMI-Feder (45)

## Eigenschaften

#### Produktmerkmale

Formfaktor	zSFP+ Gestapelt (SFP28)
Gehäusetyp	Zweireihig
Steckbarer I/O – Produkttyp	Cagesatz mit integriertem Steckverbinder
Lichtleiter-Optionen	Mit Lichtleiter
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Ja
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

## Konfigurationsmerkmale

Anschlussmatrixkonfiguration	2 x 12
Lichtleiterkonfiguration	Vierfach dreieckig (innen und außen)
Lichtleiterausführung	Standard
Anzahl der Anschlüsse	24
Anzahl von Positionen	480



#### Elektrische Kennwerte

Datenrate (max.)	32 Gb/s
Kontaktmerkmale	
Endstückbeschichtungsmaterial	Zinn
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 μm[29.92 μin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold oder Blattvergoldet über Palladium- Nickel
Klemmenmerkmale	
Anschlussstift- und Restlänge	1.8 mm[.07 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
Gehäusemerkmale	
Gehäusematerial	Nickel-Silberlegierung
Raster	.8 mm[.032 in]
Abmessungen	
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.5 mm[.059 in]
Verwendungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	-40 - 85 °C[-40 - 185 °F]
Betrieb/Anwendung	
Kühlkörperkompatibel	Nein
Zur Verwendung mit steckbaren I/O-Produkten	zSFP+ SMT-Steckverbinder
Steckbare I/O-Anwendungen	zSFP+ Thermally Enhanced
Stromkreis Anwendung	Signal
Industriestandards	
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmethode	Tray
Weitere	
Art der EMV-Eindämmung	Interne/externe EMV-Federn

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
	INDITION

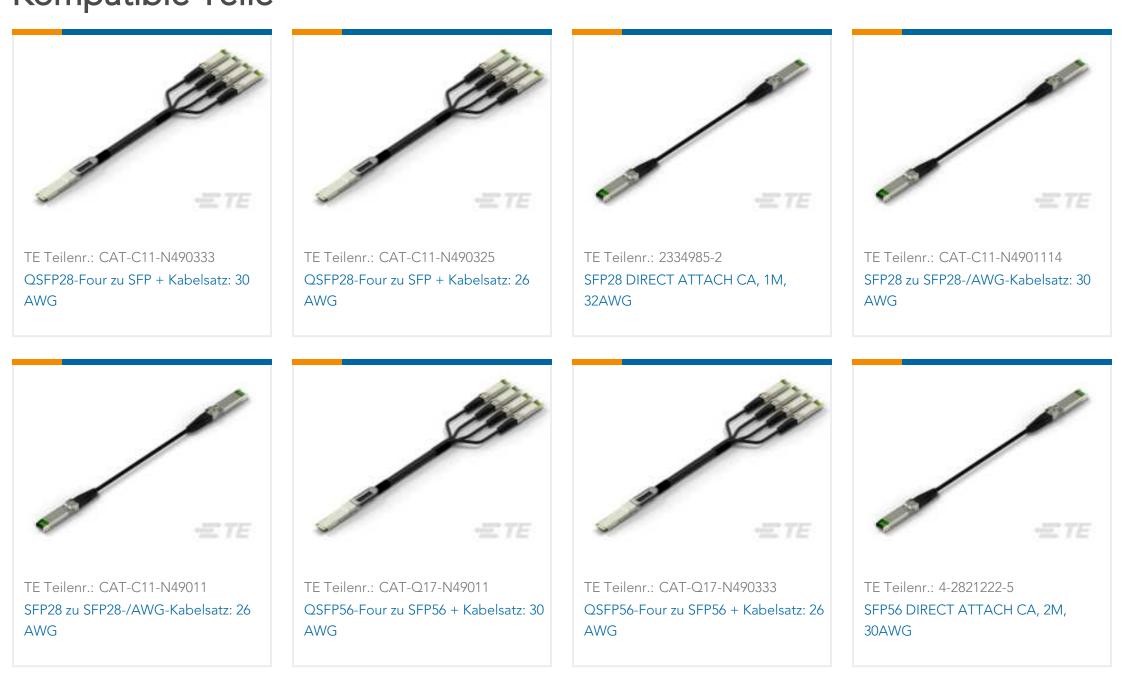


EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

# Kompatible Teile











## Kunden kauften auch diese Produkte















### Dokumente

**CAD-Dateien** 

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_2288172-6\_A.2d\_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_2288172-6\_A.3d\_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG\_CVM\_CVM\_2288172-6\_A.3d\_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu

Datenblätter/ Katalogseiten

zSFP+ Interconnect Brochure

Englisch

SFP, SFP+ & zSFP+, Cage Assembly with Integrated Connector, Data Rate (Max) 32 Gb/s, Internal/External EMI Springs, zSFP+ Thermally Enhanced

